半导体激光器系统

DS3-41614-LD



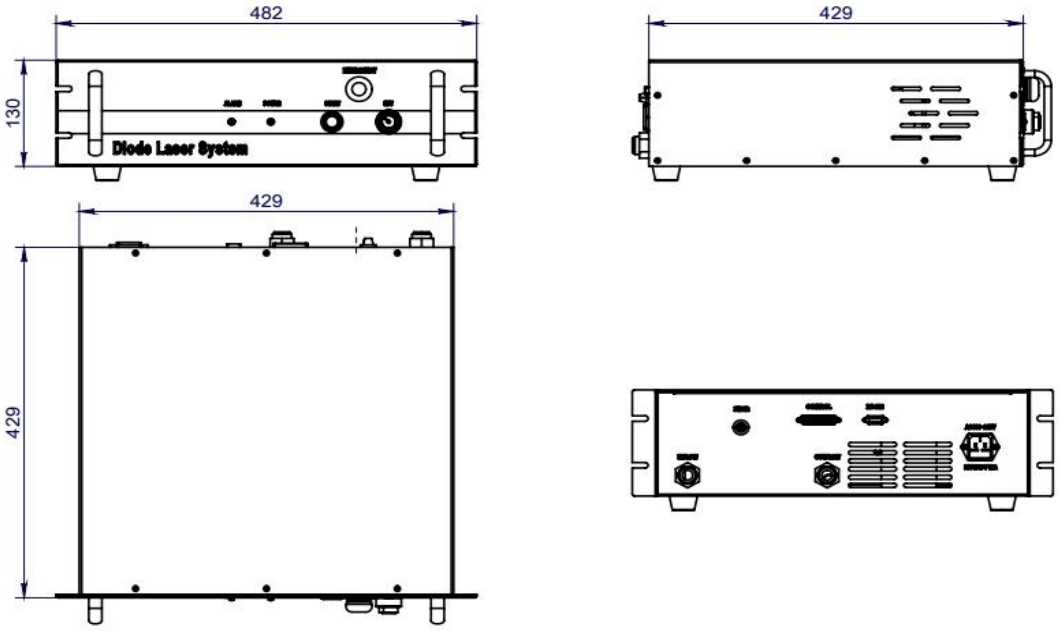
主要特性：

- 波长 976nm
- 输出功率 300W
- 光纤芯径 200μm
- 光纤数值孔径 0.22 NA

应用领域：

- 塑料焊接
- 激光锡焊
- 金属焊接

外形尺寸（mm）



使用说明

- 激光器工作时，避免激光照射眼睛和皮肤。
- 在激光器工作前，确保光纤输出端已正确清洁，请遵循安全协议以避免受伤。
- 应在额定电流、额定功率内使用。
- 工作温度 20℃~ 30℃。
- 存储温度 5℃~50℃。



半导体激光器系统

DS3-41614-LD

产品技术指标(25℃)		单位	DS3-41416-LD
光学参数(1)	输出功率	W	300
	中心波长	nm	976±10
	功率稳定性（25℃）	%	±3（5 小时）
	功率调节范围	%	10~100
光纤参数	光纤芯径	μm	200
	数值孔径	-	0.22
	光纤长度	m	2 or 定制
	连接器	-	HP-SMA905 or 定制
电学参数	输入电压	V	200~240（50-60Hz）
	功率损耗	W	<800
	驱动方式	-	恒流
	工作模式	-	连续/脉冲
	控制模式	-	RS232, I/O
	脉冲频率	Hz	1~20K
	占空比	%	5-95
	电流上升沿/下降沿	μs	≤20
指示光(2)	输出功率	mW	≥2
	波长	nm	635±10
机械参数	尺寸(L×W×H)	mm	429*482*130
	重量	Kg	<15
环境要求	制冷要求	-	水冷
	制冷能力	W	≥500
	冷却水温度	℃	25±5
	水流量	L/min	7
	水管直径(外径)	mm	12
	存储温度(3)	℃	5~50
	相对湿度	%	5~80
	激光安全等级	-	4（EN 60825-01）

（1）可根据客户需求定制光纤参数和功率输出；

（2）可根据客户需求定制红光指示光；

（3）请在非结露条件下存贮和使用。请在非结露条件下存贮和使用。

声明：北京海普林光电科技有限公司所提供的产品信息是可靠、准确的，并有权随时对产品的设计和参数进行改进和修改，恕不另行通知。26-07